

第127回マイクロ接合研究委員会
プログラム

日 時： 2019年 9月 20日(金) 10:30～16:30

場 所： 大阪大学 医学・工学研究科 東京ブランチ 913 会議室(東京 日本橋)

	時 間	題 目	講 演 者
2019 年 9 月 20 日 (金)	司 会 森 裕章(大阪大学)		
	10:30～11:15	『銅ナノペーストの活性焼結メカニズムと その応用について』 (資料番号MJ-773-2019)	古河電気工業(株)研究開発本部 ○藤原英道
	11:15～12:00	『金属塩生成接合法を用いた 各種機械材料の接合条件緩和』 (資料番号MJ-774-2019)	群馬大学大学院 理工学府 ○小山真司、 小澤昂平(現:凸版印刷)
	12:00～13:00	昼 食 休 憩	
	13:00～13:20	委 員 会 議 事	
	司 会 中島 泰(三菱電機)		
	13:20～14:05	『難燃性マグネシウム合金を用いた細径摩擦圧接』 (資料番号MJ-775-2019)	日東制機(株) ○相馬健一郎
	14:05～14:50	『はんだ材料の技術動向』 (資料番号MJ-776-2019)	(株)タムラ製作所 電子化学実装事業本部 ○柴崎正訓
	14:50～15:00	休 憩	
	司 会 岡本 康寛(岡山大学)		
15:00～15:45	『アルミニウム合金とマグネシウム合金の 異材レーザーブレイジングとインサート材の効果』 (資料番号MJ-777-2019)	大阪大学大学院 工学研究科 ○小椋智、才田一幸	
15:45～16:30	『はんだを緩衝材に用いた超音波接合による 導電性繊維上への小型電子部品の実装』 (資料番号MJ-778-2019)	大阪大学大学院 工学研究科 ○森裕章	

※プログラムは都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。